

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-031

天水华天科技股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议、2021年3月1日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体内容详见公司分别于2021年1月20日、2021年3月2日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2021-002、2021-005、2021-010）。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司董事会对本次非公开发行股票方案进行调整。2021年5月27日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，本次调整主要内容如下：

一、本次非公开发行股票方案调整情况

本次募集资金用途调整情况如下：

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过51亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	募集资金拟投入金额
1	集成电路多芯片封装扩大规模项目	115,800.00	90,000.00
2	高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目	115,038.00	100,000.00
3	TSV及FC集成电路封测产业化项目	132,547.00	120,000.00
4	存储及射频类集成电路封测产业化项目	150,640.00	130,000.00
5	补充流动资金	70,000.00	70,000.00
	合计	584,025.00	510,000.00

募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入的金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再按照相关法规规定的程序以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 51 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	募集资金拟投入金额
1	集成电路多芯片封装扩大规模项目	115,800.00	109,000.00
2	高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目	115,038.00	103,000.00
3	TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目	98,320.00	90,000.00
4	存储及射频类集成电路封测产业化项目	150,640.00	138,000.00
5	补充流动资金	70,000.00	70,000.00
合计		549,798.00	510,000.00

募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入的金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再按照相关法规规定的程序以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

二、本次非公开发行股票方案调整履行的相关程序

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金运用计划进行了调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，上述事项已经第六届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次调整后的非公开发行

股票方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日